

# 邓林

男 | 24 | Tokyo

13476163669 | denglin95@foxmail.com



## 个人描述

985

学习能力

海外留学

硬件开发

FPGA

英语流利

研二在读学生，通信工程专业，具备丰富的开源硬件开发与电路设计经验。学习能力强，人际关系良好，拥有极高的团队合作意识。有国外生活经验，英语能力强，能够兼容公司海内外业务。

## 教育背景

2017~2020 | 东京工业大学 | 通信工程 | 硕士

绩点：3.14

成绩排名：中等

主修课程：

Human-Centric Information Systems, Communications and Computer Engineering, Statistical Theories for Brain and Parallel Computing, Advanced Measurement of Sensory Information等

荣誉奖励：暂无

2013~2017 | 华中科技大学 | 电子封装技术 | 本科

绩点：3.76

成绩排名：前30%

主修课程：模拟电路，数字电路，微电子技术，电子制造技术，先进基板技术，电子封装模拟等

荣誉奖励：2017优秀毕业生

## 实习经历

GoPro

电子工程实习生

2019-07~2019-11

协助公司正式电子工程师，基于产品开发、生产与调试过程中出现的问题，进行测试的设计与实施，并完成相关评估报告，同时根据测试结果以及设计文件提出相应的解决方案。独立完成GoPro Hero 8/Hero 7/Hero 6的MP阶段Smoke Test。与ME团队合作进行测试模组设计，设计并绘制多块电路板。

中国铁塔股份有限公司德阳市分公司

实习生

2018-08~2018-09

了解IoT在铁塔行业中的实际项目，学习先端技术在工业生产中的展开方式，从投/招标方的角度对行业进行认知，加深了对于技术在工程应用中的理解。

珠海元盛电子有限公司

实习生

2016-07~2016-07

深入柔性基板制造车间进行实践，将电子产品的生产与自己在学校所学习的知识相互印证，加深对于电子封装行业的理解，掌握柔性电路基板的生产流程。

## 学术经历

## Cell-based QCM Biosensor for Detecting Odorant in Gas Phase ( 基于细胞的气相气味QCM传感器 )

研究者

2017-09~2020-04

独立设计并搭建基于QCM的嗅觉传感系统，主要工作包括FPGA数字电路设计、PCB电路设计、Matlab操作软件编写、实体系统搭建等，实现对QCM共振频率的高解析度监测。系统搭建工作完成后，使用测定系统进行生物传感材料(细胞/蛋白质)研究，提升生物嗅觉传感器的稳定性与可复现性。近期以"Cell-based QCM Biosensor for Detecting Odorant in Gas Phase" 为题成功投递2019 IEEJ Workshop，并在会议上完成发表。

## Ge纳米线的可控生长与表征

毕业设计

2017-01~2017-05

基于Ge-Au相图，通过控制PVD与CVD过程中的沉积条件如膜厚、气压、温度、升温梯度等，实现Ge纳米线在气相环境中的可控生长。

## BGA芯片封装热应力分析及无芯基板热压合形变分析

课程设计

2016-04~2016-04

对指定制式的BGA封装芯片简化建模，通过Ansys进行散热、应力、变形等分析，并撰写分析报告。同时对无芯基板技术进行论文调研，建模并通过Ansys模拟热压合过程中的基板形变，完成分析报告。

## 校园实践

### 小型低能耗电池仓温湿度记录器

开发者

2019-07~2019-11

独立开发并实现一个小型低能耗的温湿度记录仪模块，包括母板与烧写板两个部分，工作涉及电路设计、PCB layout、打样、元器件采购、PCB 焊接、3D 打印外壳设计、固件编写、调试以及数据提取程序的编写，目前项目仍处于中间调试阶段。

### 具有颜色识别功能的自动机械手分拣系统

参赛队员

2015-11~2016-02

组建队伍参加华中科技大学赛灵思开源硬件创新创业比赛，作为队员负责自动机械手的程序编写，包括指令阅读与执行、伺服电机驱动以及目标位置的调整，进入决赛并获得二等奖。

### 将普通打印机DIY成3D打印机

参赛队员

2014-12~2015-04

组建队伍参加华中科技大学“海信宽带杯”创新设计大赛，作为队员参与部分3D打印机的功能优化，添加外部中断信号，进行机械电路组装，完成参赛相关文件的编撰，进入决赛并获得一等奖。

### 3D打印团队

控制组组长

2014-10~2015-10

主导基于Arduino平台的FDM设备的开发，完成三维空间的电机系统驱动、G-code指令的读取与处理和SD卡文件读取，实现系统的初步运作。同时参与部分3DP设备的开发与优化，协助搭建机械实体平台。

## 语言能力

英语：TOEFL ( 105 )

日语：N2 ( 120 )

中文普通话：二级甲等 ( 91 )

## 专业技能

电路设计

熟练，使用Orcad、Altium与Eagle等EDA软件进行设计，有五块单板以上的设计经验。

#### PCB Layout

熟练，使用Allegro、Altium与Eagle等EDA软件进行设计，有双层板及四层板的设计经验。

#### 计算机语言

良好，掌握C++、Python、Matlab、VHDL等基础计算机语言，有一定项目开发经验。

#### 建模分析

一般，能够使用Ansys、Solidworks与Fusion360等软件进行设计仿真。同时有Modelsim时序仿真经验。

#### 办公文书

熟练，掌握Word、Excel、Powerpoint等常用办公软件。

### 兴趣爱好

看书，看电影，极限运动